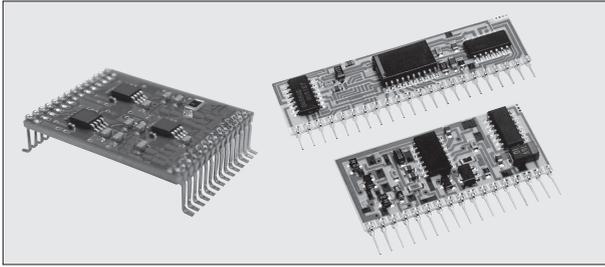


KA ■ 定制混合IC



■ 特点

- 根据功能和比例的调整可以降低工时。
- 各种包装对应可能。
- 由于使用KOA的厚膜技术使其信赖性向上。

■ 欧盟RoHS对应

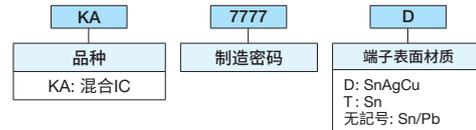
- 厚膜印刷基板，印刷电路板都进行各构成部件的优化内部连接实现了无铅化。

■ 用途

- 汽车设备 (ECU、电动车窗)
- 电源设备 (DC/DC转换器、AC/DC转换器、稳定电路·锂电池充放电电路)
- 工业设备 (各种控制电路)
- 通信设备 (电话交换机、LAN·无线收发器、VCO·VTXO)

■ 品名构成

实例



■ 构成零件

KA Series			
基板材料	项目	印刷	贴装
基板材料	Al ₂ O ₃ 氧化铝	○	○
	玻璃环氧树脂	×	○
导体·电阻	项目	Ag-Pd	Ag-Pt
	导体电阻	18mΩ/□/15μm	5mΩ/□/10μm
	热冲击	-55°C~+125°C 300 Cycles	-55°C~+125°C 500 Cycles
	电阻体	5Ω~10MΩ ±100×10 ⁻⁹ /K	
贴装	项目	规格	
	BGA	0.5mm Pitch~	
	QFP	0.4mm Pitch~	
	Chip	0.4mm×0.2mm~	
形状·外部端子	形状	导线间距	
	SIP	1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 2.54mm	
	DIP、SOP	1.27mm, 1.8mm, 2.54mm	
	ZIP	2.54mm	
	BGA、LGA	1.0mm~	
外装·表面处理	外装	颜色	UL标准
	环氧系变成苯酚	黑	94 V-0认定品
	环氧树脂	黑	94 V-1认定品

以厚膜电路板的形式发货。